

各位

会社名 T O W A 株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 博和
(コード番号 6315 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 中西 和彦
TEL (075) 692 - 0251

中国における半導体製造装置事業の強化について

- お客様に近い場所に開発拠点を設置することで、より強固な関係構築を目指す -

T O W A 株式会社(以下、T O W A)は、中国における事業活動をさらに強化するため、技術開発に特化した新会社の設立を予定しており、9月16日に現地(中国江蘇省)にて蘇州工業園区管理委員会と設立に関する調印式を執り行いましたのでお知らせいたします。

なお、新会社の概要は以下のとおりです。

記

1. 新会社設立の目的

中国は、今や世界最大の半導体製造装置市場であり、半導体需要の増加とともに、その市場規模はますます拡大しております。T O W A は、中国を重要な地域と位置付け、これまで現地にて工場の増築や新工場の建設、M&A(事業譲受)などを行い、生産能力の拡張や、半導体製造装置の設計・生産から販売、アフターサービスまでを現地のみでトータルにサポートできる体制を構築するなど、お客様のニーズに応じてまいりました。

現在、半導体内製化を推し進める中国では、非常に早いペースで技術が進歩しており、求められるニーズも日々変化しております。そのため、お客様に近い場所に開発拠点を設置し、それらのニーズに迅速に応えるとともに、最新設備を保有するラボ機能を備えお客様の開発段階よりT O W A が試作・評価をサポートするなど、より柔軟で質の高いサービスを提供することで、お客様とこれまで以上に強固な関係構築を目指してまいります。

2. 新会社の概要

- (1) 名称：東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司<仮称>
- (2) 所在地：中華人民共和国江蘇省蘇州市蘇州工業園区東長路88号
- (3) 出資者：T O W A 株式会社 100%
- (4) 登録資本：300万米ドル
- (5) 代表者の氏名：岡田博和(董事長)
- (6) 従業員数：約50名
- (7) 業務内容：半導体製造用精密金型・装置の開発及び設計、半導体パッケージの試作・評価
- (8) 設立日：2021年10月初旬<予定>

以上